

<<接插件电镀>>

图书基本信息

书名：<<接插件电镀>>

13位ISBN编号：9787118049985

10位ISBN编号：7118049980

出版时间：2007-5

出版时间：国防工业

作者：沈涪

页数：180

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<接插件电镀>>

内容概要

本书对电子元件中近几年来需求量较大、在电器上使用较为广泛的接插件的电镀工艺进行了综合性描述。

书中在介绍以电连接器为代表的接插元件的各类电镀工艺时，以一些常见的质量问题结合实例的分析作为重点，同时尽量辅以各类相关图片加以说明，以帮助读者对这些质量问题作进一步的分析。

本书突出以应用为主的特点，除了对国内接插件行业近些年来常用的电镀工艺的应用情况作了简短回顾外，着重对接插件电镀的操作程序特别是镀前和镀后处理的工作作了详细介绍。

本书对目前应用于接插件电镀的几种新兴电镀方式的技术及设备的工作原理结合生产中的使用经验作了基本总结，同时也对接插件电镀的发展方向作了简单预测。

本书适合从事接插件电镀的工人及技术人员参考，也可作为相关专业的培训教材。

<<接插件电镀>>

作者简介

沈涪，四川绵阳市人，生于1953年8月，高级工程师，毕业于南京大学无机化学专业。从20世纪80年代初至今一直在电子部796厂（现绵阳华丰企业集团有限公司）从事电镀工艺工作。其间参加了电子部组织的“六五”镀金工艺攻关和镀银工艺攻关。曾于80年代末期在法国苏里奥（SOURIAU）公司学习振动电镀技术和铝件化学镀镍技术。从90年代初开始先后参与了多条电镀生产线的引进、安装调试和国产化配套研制工作。近几年主要承担公司军品、“七专”产品以及重点新品项目电镀工艺配套研制和生产线工艺管理工作。

现为绵阳华丰企业集团公司电镀工艺副主任工艺师；中国电子学会生产分会理事；中国电子学会电镀专业委员会西南地区责任委员；中国电子学会电镀专业委员会接插件电镀专题研究会主任。

<<接插件电镀>>

书籍目录

第1章 镀前准备1.1 镀前检验1.2 镀前处理1.2.1 去毛刺1.2.2 镀件清洗1.2.3 降低基体表面粗糙度1.2.4 镀件活化1.3 确定电镀方式1.3.1 各种电镀方式的特点1.3.2 几种零件混镀1.4 镀液镀前检查和电镀主要参数计算1.4.1 镀液镀前检查项目1.4.2 电镀主要参数计算1.5 电镀设备检查1.5.1 电镀电源1.5.2 温控系统1.5.3 循环过滤系统1.5.4 镀液补充系统参考文献第2章 电镀工艺2.1 接触体电镀工艺2.1.1 接触体镀金工艺2.1.2 接触体镀银工艺2.1.3 接触体镀锡和镀锡铅工艺2.1.4 其他接触体电镀工艺2.2 外壳电镀工艺2.2.1 外壳镀锌工艺2.2.2 外壳镀镉工艺2.2.3 外壳镀镍工艺2.2.4 其他外壳电镀工艺参考文献第3章 接插件电镀中新兴的电镀方式3.1 振动电镀3.1.1 振动原理3.1.2 设备类型3.1.3 振动电镀工艺3.1.4 使用振动电镀应注意的事项3.2 带料电镀3.2.1 带料连续选择性电镀设备3.2.2 带料连续选择性电镀方法3.2.3 带料连续选择性电镀工艺3.3 可伐合金玻璃封接电连接器电镀3.3.1 传统的可伐合金连接器多层电镀工艺3.3.2 可伐合金连接器选择性电镀工艺3.3.3 在采用选择性电镀工艺过程中要注意的问题3.4 铝外壳化学镀镍3.4.1 铝外壳基体质量3.4.2 化学镀镍工艺选择3.4.3 铝外壳化学镀镍工艺流程3.4.4 化学镀镍设备3.4.5 铝外壳化学镀镍应注意的问题参考文献第四章 镀后处理4.1 镀后处理与镀层质量的关系4.2 镀后处理工作内容4.2.1 镀后清洗4.2.2 高温处理4.2.3 镀后钝化4.2.4 镀后浸涂防护剂4.2.5 镀后检验4.2.6 镀后镀件的包装、运输和储存4.3 镀后处理要注意的一些问题4.4 不合格镀件的返镀4.4.1 镍打底镀金零件返镀工艺4.4.2 镀银零件返镀工艺4.4.3 镀锡铅合金零件返镀工艺4.4.4 铁基体、铜及铜合金基体外壳镀镍退镀工艺4.4.5 带料零件返镀工艺参考文献第5章 接插件电镀的发展方向5.1 新兴电镀方式将逐步取代常规的传统电镀方式5.1.1 以振动电镀方式替代常规滚镀5.1.2 以带料电镀为提高产品生产效率奠定基础5.1.3 以化学镀开辟新材料在接插件产品的应用前景5.2 选择性电镀将成为接插件电镀的主要电镀方式5.2.1 散件接触体选择性电镀5.2.2 外壳选择性电镀5.3 电镀新设备、新工艺将会在接插件电镀行业得到进一步推广5.3.1 TTH镀层5.3.2 铝件等离子放电氧化工艺5.3.3 电镀方式和电镀装置的改进5.4 实施清洁生产和坚持科学的全面质量管理才是提高产品竞争力的唯一途径参考文献

<<接插件电镀>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>